证券代码：688182　　证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2024 年 1 月 26 日）

编号：2024-002

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	财通证券、中银国际证券
时间	2024 年 1 月 26 日
地点	灿勤科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：陈晨女士
投资者关系活动主要内容介绍	**第一部分：告知保密义务** **第二部分：问答环节** **1、问：公司的主营业务是什么，有哪些应用领域？** 答：公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司自成立以来，依托在陶瓷粉体配方和产品制备工艺领域的持续研发和经验积累，始终专注于电子陶瓷元器件的研制和开发。公司通过向客户提供高效稳定、专业可靠的元器件产品及通信解决方案，不断提升企业的品牌与价值,谢谢。 **2、问：公司近两年设立的子公司情况？** 答：近两年，公司共设立三家控股子公司。分别是 1、苏州拓瓷科技有限公司，成立于 2022 年 5 月，注册资本 2000 万元，灿勤科技持股比例 51.00%，主营业务：金属陶瓷结构与功能器件的研

	发、生产和销售；2、苏州互迭科技有限公司，成立于 2022 年 12 月，注册资本 2000 万元，灿勤科技持股比例 50.20%，主营业务：射频模块与系统的研发、生产和销售；3、苏州频普半导体科技有限公司，成立于 2023 年 3 月，注册资本 2000 万元，灿勤科技持股比例 65.00%，主营业务：研发、生产加工半导体薄膜及 MEMS 工艺电路等元器件产品。谢谢。 **3、问：公司 HTCC 陶瓷产品，主要包括哪些产品，用于哪些领域?** 答：陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，主要这三大类，主要应用于新能源、IGBT 热管理、半导体封装和无线通信等领域。谢谢。 **4、问：想问下高端陶瓷器件的技术壁垒主要哪些?** 答：电子陶瓷元器件的研发、生产涉及材料科学、电子技术、机械技术、化学等众多领域，研发难度大，设计难度高，生产工艺复杂，属于典型的技术密集型产业。 ① 材料壁垒 自有粉体配方是电子陶瓷元器件厂商的核心竞争力。电子陶瓷元器件的粉体配方必须满足高精细度、高纯度、高分散性、化学均一、高结晶度等一系列严格的技术要求，其研发过程往往需要长期的实验、检测和数据积累、分析，研发周期较长。相关配方均属于各企业的商业秘密，难以进行逆向工程和复制，行业进入者难以复制现有企业的竞争优势。 ② 工艺壁垒 电子陶瓷元器件的生产加工需要有较强的制备能力。成熟的生产工艺依靠长期的经验积累，需要在实践中不断摸索才能取得，如生产过程中的烧结工艺、成型工艺等均需要长周期、高投入的实践经验摸索。不成熟的生产工艺生产出的陶瓷产品容易碎裂、变形、收缩，产品的良率较低，导致生产成本更高。企业需要建立起一整套严格的工艺流程控制、检测手段，从而保证生产的标准化、系列化，从零开始积累的难度较大。厂家在工艺研发成功后，均会采用专利、商业秘密等手段加以保护，潜在竞争者很难在短期内取得能满足市场需求的高性能产品的生产工艺。 ③ 创新研发壁垒 电子陶瓷元器件下游应用领域不断扩大，由于下游行业的快速发展，技术更新速度较快，对电子陶瓷元器件厂商的创新能力有较高的要求，上游元器件厂商需要具备独立的研发平台、先进的研发设备、较强的研发团队、较快的研发响应速度。如果缺乏较强的研发团队、自主核心技术、生产技术管理能力，将缺乏持续的研发创新能力，难以满足快速变化的市场需求，无法在市场上长期生存和发展。 综上所述，电子陶瓷元器件行业的新进入者难以在短时间内掌握粉体配方等核心技术，生产工艺也需要较长时间的积累，在

	无核心技术、研发平台、研发团队的情况下难以适应市场需求的快速变化，进入壁垒较高。谢谢。 **5、问：公司未来具体的发展计划有哪些？** 答：1、创建一流的电子陶瓷材料研发平台 电子陶瓷材料作为核心基础原材料，是实现各种电子元器件的基础，也是实现公司战略目标的关键。作为基础材料，电子陶瓷材料在介电特性、损耗特性、热力学特性等方面是电子元器件的发展核心，其重要性对电子元器件不言而喻。经过几十年的发展，各种新型电子陶瓷材料和新型应用层出不穷。随着 5G 建设大规模开展及万物互联时代的到来，各种新应用对电子设备的性能、能耗、可靠性、成本提出了越来越高的要求，也给电子陶瓷材料的发展和壮大提供了广阔的舞台。电子陶瓷材料的开发，将是材料学科的下一个蓝海。 在电子陶瓷材料领域，一方面，公司将在现有基础上不断完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑超低频、超高频射频介质滤波器、天线等产品的应用。另一方面，公司将依托现有的陶瓷材料研发体系及经验，拓展电子陶瓷材料应用的新领域，着力开发一批 HTCC 陶瓷、LTCC 陶瓷、高强度介质陶瓷、热管理陶瓷、储能陶瓷、复合陶瓷材料等先进陶瓷材料。在电子陶瓷先进工艺领域，公司将加大投入并着力打造面向未来的，全体系的电子陶瓷先进工艺技术平台，涵盖陶瓷材料制备、陶瓷体加工、陶瓷金属化及表面处理、陶瓷组装等工艺领域，为电子陶瓷的广泛应用打下坚实的基础。 2、巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位 随着基站用陶瓷滤波器的市场需求不断增长，公司目前已成为国内外主要通信设备制造商的重要供应商。面对通信产业以介质滤波器为代表的各类陶瓷射频元件的市场需求，公司拟加大投入力度，进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院等。 在介质滤波器、介质谐振器、介质天线等射频器件方面，依托公司积累的设计制造经验和广泛的客户认可度，大力推广该类产品的市场应用，完善公司在移动通信市场的布局，成为射频元器件无源器件的综合供应商。 3、拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等万物互联的应用市场 电子陶瓷作为功能陶瓷领域的一个重要分支，在现代通讯、半导体、电力电子、交通运输、航空航天等领域已有广泛应用，并形成了一批起源于日本、美国等的电子陶瓷头部企业。随着这些产业的半导体技术、新能源技术、AI 等核心技术的快速发展，电子陶瓷的应用领域将进一步拓宽，为人类社会发展作出更加巨大的贡献。公司将对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体、万物互联等市场，深度拓展电子陶瓷新应用。 在新能源、半导体、万物互联等领域，公司将依托先进电子

	陶瓷材料、全体系电子陶瓷加工工艺等平台，发挥积累多年的电子陶瓷元器件的设计制造经验，研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本的电子陶瓷产品，涵盖陶瓷封装、陶瓷基板、陶瓷热沉、复合陶瓷、LTCC 器件、介质陶瓷元器件等一系列产品及解决方案，以满足新能源、半导体、万物互联等产业的发展需求。谢谢。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（ 如有）	无
日期	2024 年 1 月 30 日